附件2

**高级研修班教学计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | | **研修内容** | **授课专家** |
| 7月5日 | | 学 员 报 到 | |
| 7月6日 | 上午 | 北京集成电路产业的发展实践 | 北京市经信局相关领导 |
| 下午 | 碳达峰碳中和目标解读及国内外政策背景与发展历程 | 产业领域专家领导 |
| 7月7日 | 上午 | 新基建下中国半导体产业未来发展之路 | 魏少军，清华大学教授、中国半导体行业协会IC设计分会理事长。 |
| 下午 | 后摩尔时代大规模集成电路器件与集成技术 | 张兴，北京大学软件与微电子学院集成电路与智能系统系教授。 |
| 7月8日 | 上午 | 中国大陆集成电路技术和产业发展现状 | 赵超，中国科学院微电子研究所副总工程师、博导研究员。 |
| 下午 | 飞速发展的半导体科学技术 | 陈弘达，中国科学院半导体所研究员、博士生导师，曾任中科院半导体所副所长，国家863计划新材料领域专家组成员。 |
| 7月9日 | 上午 | 现场教学：我国集成电路产业发展的机遇与挑战（教学地点：北京燕东微电子） | 淮永进，北京燕东微电子股份有限公司总经理。 |
| 下午 | 现场教学：智慧物联、智能生产（教学地点：京东方集团） | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 结业、返程 | |